

公司代码：688380

公司简称：中微半导

中微半导体（深圳）股份有限公司
2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营活动中可能存在的相关风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”。

3、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、 公司全体董事出席董事会会议。

5、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

7、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2025 年度利润分配预案为：公司拟以实施 2025 年度权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），公司不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。

截至 2025 年年度报告披露日，公司总股本 400,365,000 股，扣除公司回购专用证券账户中 1,506,639 股后的股本 398,858,361 股为基数，预计派发现金红利总额为 119,657,508.30 元。如在分配方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日前，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司 2025 年利润分配预案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议通过。

母公司存在未弥补亏损

适用 不适用

8、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	中微半导	688380	不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴新元	赵羽佳
联系地址	深圳市前海深港合作区桂湾三路91号前海金融中心T1栋21楼	深圳市前海深港合作区桂湾三路91号前海金融中心T1栋21楼
电话	0755-26920081	0755-26920081
传真	0755-26895683	0755-26895683
电子信箱	info@mcu.com.cn	info@mcu.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

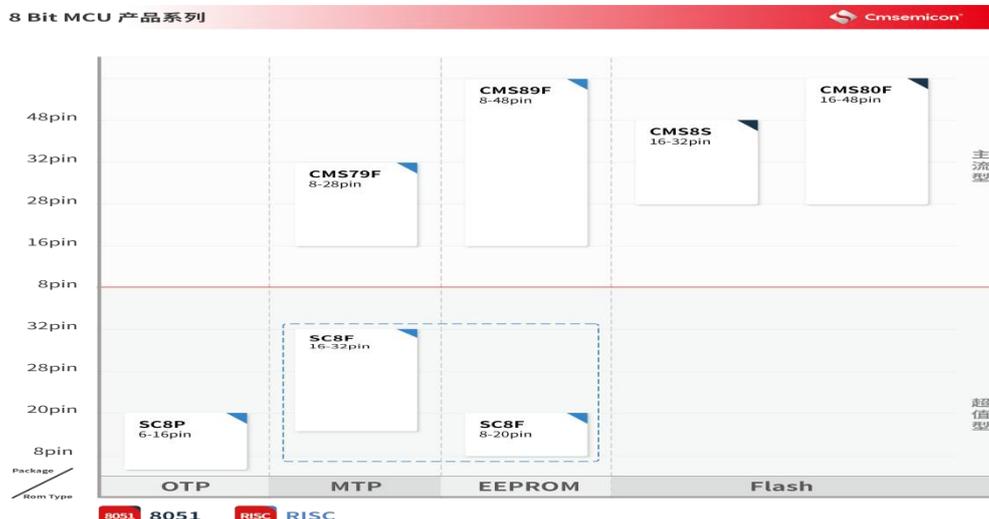
公司是中国领先的智能控制方案解决提供商，专注于以 MCU 为核心的芯片研发、设计与销售，力求为智能控制器提供一站式整体解决方案。公司前身为 1996 年成立的一家芯片应用方案公司，创始人在方案开发过程中萌发芯片设计初心，2001 年跨界进入芯片设计行业并成立公司。

公司自成立以来，围绕控制器所需芯片从 ASIC 芯片设计开始，不断拓展技术布局，如今掌握 8 位和 32 位 MCU、高精度模拟、功率驱动、功率器件、无线射频和底层核心算法等设计能力。产品在 55 纳米至 180 纳米 CMOS、90 纳米至 350 纳米 BCD、双极、SGT MOS 和 IGBT 等工艺上投产，并逐步向 40 纳米、22 纳米等更高制程迈进，广泛应用于消费电子、智能家电、工业控制、医疗健康、汽车电子等领域。

公司主要产品包括 MCU、ASIC（高精度模拟、电源管理、通信交互、功率驱动等）、SoC 等芯片以及功率器件和底层核心算法，可为智能控制器提供芯片级一站式整体解决方案。

MCU 是芯片级的计算机，又称单片机，是把中央处理器(CPU)的频率与规格做适当缩减，并将内存(Memory)、计数器(Timer)、USB、A/D 转换、UART、DMA 等周边接口，甚至 LCD 驱动电路都整合在单一芯片上，形成芯片级的计算机。MCU 芯片的组成部分可分为：中央处理器、存储器、以及输入/输出。MCU 芯片按用途分类可分为通用型和专用型。通用型 MCU 芯片指的是将可开发的资源（ROM、RAM、I/O、EPROM）等全部提供给用户。专用型 MCU 芯片指的是其硬件及指令是按照某种特定用途而设计，例如录音机机芯控制器、打印机控制器、电机控制器等。公司是国内最早自主研发设计 MCU 的企业之一，如今 MCU 产品覆盖 8 位和 32 位全系列。

其中 8 位 MCU 基于高性能 8 位精简指令集内核及 8051 内核设计，包括 CMS79xx、CMS89xx、SC8Fxx、SC8Pxx 等系列，产品资源主要涉及 AD、触摸、运放、LED/LCD 等，并提供优化的模拟和数字外围设备、灵活的引脚映射和高系统时钟频率，配合公司自主研发的评估套件、开发工具及免费软件，帮助用户评估、开发、调试并最终加快产品上市速度。公司 8 位 MCU 系列具体如下图所示：



32 位微控制器是基于 ARM® Cortex® M0、ARM® Cortex® M0+、ARM® Cortex® M4 的产品，其高速的运算处理能力能胜任绝大多数复杂应用。其中的低功耗、高性能系列，多达 256KB 的 Flash，32KB SRAM，2KB 的 Data Flash，工作电压 1.8V~5.5V，且片上集成多种模拟外设如运放、比较器、可编程增益放大器等，依据不同资源需求，提供大资源、多管脚、易扩展的优势广泛应用于多种场合。具体 32 位 MCU 系列如下图所示：



ASIC 是专用集成电路，是指应特定用户要求或特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路，例如 ADC、DRAM、FLASH 等这些具备明确单一功能的，或者 H.264 编解码、802.3 协议、5G 基带等特定应用场景的芯片，功能相对单一的 ASIC 在批量生产时与通用集成电路相比具有体积小、功耗更低、可靠性提高、性能提高、保密性增强、成本降低等优点。公司 2002 年推出自主设计的第一款专用芯片——燃气热水器定时芯片，2014 年进入栅极驱动设计，2018 年进入高精度模拟产品

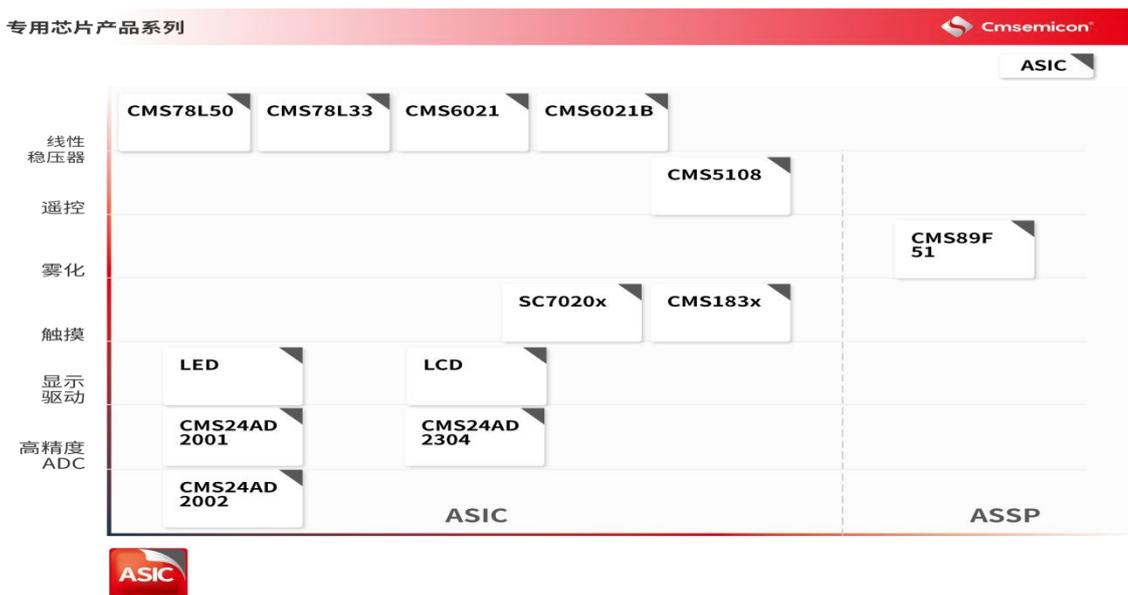
设计。目前，公司针对特定领域推出具备完美性价比及能效优势的专用芯片系列，产品包括传感、触摸、显示驱动、电机驱动、高精度 ADC、BMS 模拟前端、遥控、线性稳压器等。

数据转换芯片主要包括模数转换（ADC）和数模转换（DAC）芯片。ADC 用于将真实世界产生的模拟信号转换成数字信号进行输入，数字集成电路进行信号处理，然后用 DAC 将数字信号调制成模拟信号进行输出。公司的高精度 ADC 产品，通过采样和噪声整形等方式提高了测量的精度，其中 24 位高精度 ADC 的有效精度达到 21.5 位。

电源管理芯片是在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的关键器件，使得电压和电流应保持在设备可以承受的规定范围内，其性能优劣和可靠性对整机的性能和可靠性有着直接影响，功能一般包括电压转换、电流控制、电源选择、电源开关时序控制等。公司的电源管理芯片主要产品包括线性电源 LDO 和开关电源 DC-DC 等。其中 LDO 为低压差线性稳压器，用于实现低压差场景下的降压转换，具有低噪声、纹波小、高精度等特征；而 DC-DC 可以实现降压、升压、升降压转换等多种功能，电压及电流适用范围更广，能够实现高转换效率。

功率 IC 是半导体芯片中模拟芯片的典型代表，可实现功率（电压、电流、频率）的变换控制与调节，为后续电子元器件提供相应的功率供应和管控要求。公司栅极驱动 IC 主要为电机驱动 IC，其能够将电机控制器/MCU 输出的低压控制信号转换成驱动功率器件的高压驱动信号，来驱动功率器件进行开关动作，从而驱动电机工作，集成了高侧和低侧驱动器，可降低开关损耗，适应嘈杂的环境并提高系统效率。公司的驱动 IC 产品包含单相半桥、全桥、三相全桥产品系列，可满足多种场景的应用要求。

公司的 ASIC 芯片系列如下图所示：

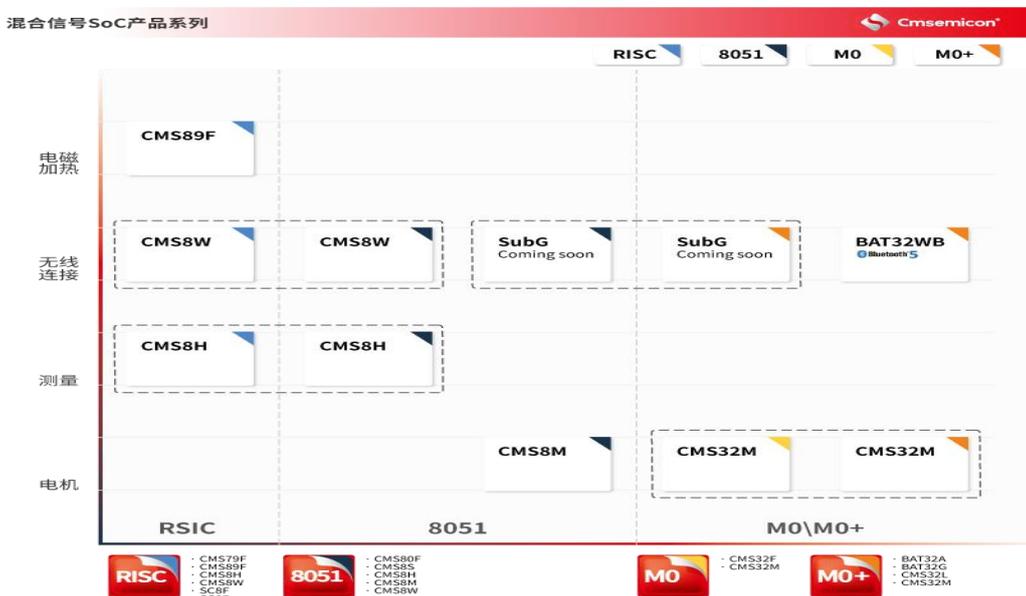


SoC 是系统级芯片，又称片上系统，一个专用目的的集成电路，是由多个具有特定功能的集成电路组合在一个芯片上形成的系统或产品，其中包含完整的硬件系统以及承载的嵌入式软件。SoC 芯片组成可以是系统级芯片控制逻辑模块、微处理器/微处理器 CPU 内核模块、数字信号处理器 DSP 模块、嵌入的存储器模块、外围通信接口模块、含有 ADC/DAC 的模拟前端模块、电源提供和功耗管理模块、用户定义逻辑以及微电子机械模块，以及内嵌的基本软件模块或可载入的用户软件。

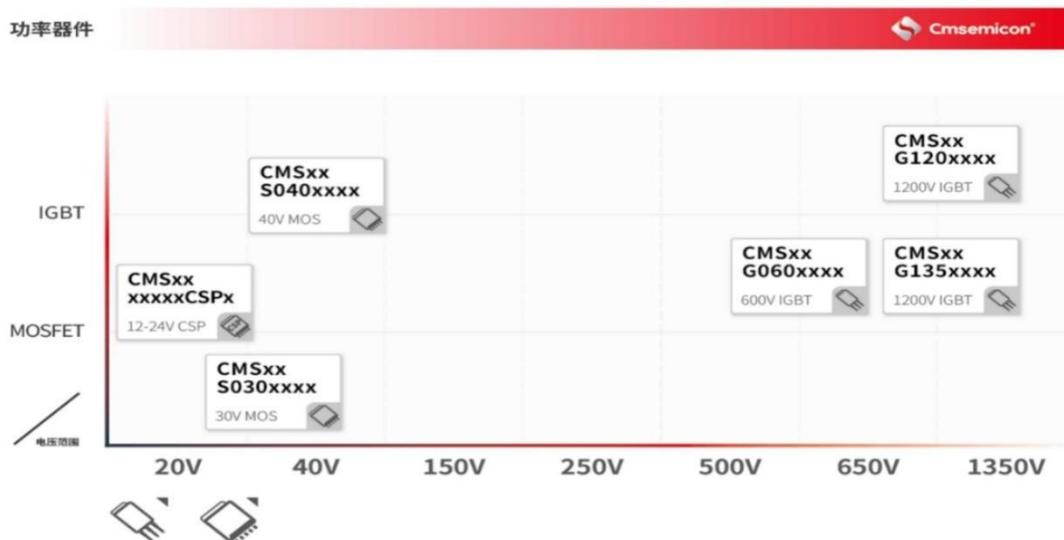
SoC 芯片通常为客户定制或是面向特定用途的标准产品。公司以高度集成的优势，将数字和模拟 IP 设计在同一颗 SoC 里以实现特定的功能应用。公司的电机控制、无线充、测量、无线连接、

高压驱动、电磁加热、BMS、电动牙刷等混合信号 SoC，不但简化设计，而且有效缩减 BOM 尺寸面积，相较于传统芯片电路更小，功耗更低，可靠性更高，可以灵活且充裕的能力来执行更高级、用户应用级别的任务。

公司现有 SoC 产品如下图所示：



功率器件又叫功率分立器件，是在电力控制电路和电源开关电路中必不可少的电子元器件，主要用于电子电力的开关、功率转换、功率放大、线路保护等。MOSFET 和 IGBT 的推出，集高频、高压、大电流于一身，使功率器件的应用从单一的电力领域迅速渗透到消费电子、汽车电子、新能源、变频家电等各大领域。由于公司功率器件产品没有规模优势，早在 2024 年就停止了该类产品的持续研发。目前，公司可售的功率器件产品十分有限，具体如下图所示：



底层核心算法就是各种用于计算机自身运行的驱动程序（经过选择并可以更新）和为控制运行而编制的专用程序。公司注重底层核心软件算法的研发设计，让客户更容易使用公司产品，目前能够提供触摸库、上位机控制软件、电机底层算法等，具体如下图所示：



公司的产品广泛应用于消费电子、智能家电、工业控制、汽车电子和医疗健康领域，可为各类产品智能控制提供一站式整体解决方案。具体应用领域和场景如下图所示：

2.2 主要经营模式

随着集成电路技术、工艺的不断进步，行业内分工的逐渐细化，集成电路行业的经营模式也逐渐成熟，主要经营模式呈现为 IDM 模式和 Fabless 模式两种。

IDM 模式（Integrated Device Manufacture，即垂直一体化模式），指集成电路设计、晶圆制造、晶圆测试、芯片封装和测试均由企业内部分工协作完成。该模式便于公司内部整合资源、获取整体高额利润，但对企业的技术能力、资金实力、管理组织水平以及市场影响力等方面都有极高的要求。诸如英特尔（Intel）、三星（Samsung）等国际芯片大厂主要采用 IDM 模式。

Fabless 模式（Fabrication-Less，即垂直分工模式、无晶圆模式），指企业专注于集成电路的研发、设计及销售，将晶圆制造、芯片封测等环节分别委托给专业的晶圆制造企业和封装测试企业完成。该模式对资金和规模门槛要求相对较低，因此全球绝大部分芯片设计企业均采用 Fabless 模式。

公司采取 Fabless 经营模式，集中优势资源用于集成电路产品的研发、设计和销售环节，将全部的晶圆制造、晶圆测试及主要的芯片封装、芯片测试委外代工完成，同时自建一条研发促进、产能调节型的芯片封装、测试产线，确保研发产品的快封、快测和必要芯片封装、测试的产能调节。主要产品的工艺流程图如下所示：



1、研发模式

公司以市场需求为导向，基于集成产品开发（IPD）理念构建了规范、严格的芯片产品开发流程。IPD 贯穿产品的概念、设计、开发、验证、发布和生命周期阶段，在 IPD 理念下，公司通过组建市场、研发、质量等跨部门人员参与的产品开发团队（PDT），实现从方案设计、芯片设计、芯片验证到芯片维护的全流程技术和质量把控，确保研发成果向市场产品的高效转化。公司的芯片产品开发流程具体如下：

（1）方案设计阶段

公司市场部门、各事业部、研发中心密切跟踪市场发展趋势、行业技术动态和行业政策法规变化，通过客户沟通等方式参与市场需求搜集，经评审通过后，研发中心开展立项可行性分析，内容涵盖产品定义、产品功能和特色、市场分析、技术方案、风险分析等，并发起立项申请，经审议通过后项目正式立项。系统工程师进行产品需求规格分解，定义产品规格；IC 工程师对产品的关键功能和参数进行仿真；质量工程师制定质量保障计划，确定产品质量目标和质量保障活动。决策管理团队进行计划决策评审（PDCP），通过后进入芯片设计阶段。

（2）芯片设计阶段

产品研发部制定设计开发任务书，明确项目分工和人员安排。IC 工程师进行设计失效模式及后果分析（DFMEA），根据 DFMEA 分析结果进行数字电路和模拟电路设计，以达到产品的功能需求，并对电路进行软件仿真，验证设计方案的可行性。版图工程师针对 IC 工程师的设计结果对产品进行版图设计。IC 工程师汇总版图设计之后的接口文档，确定封装信息与产品特性，由质量部根据工厂资质和产能，确认供应商清单。测试工程师依据产品的功能和仿真结果，制定芯片验证方案，进行软硬件设计，工具工程师进行 IDE/编程软件/编程调试器的设计。在上述设计审议通过后，决策管理团队进行投片决策评审（TDCP），通过后进行流片。

（3）芯片验证阶段

晶圆代工厂流片成功后，研发中心下达封装任务确认单，发往封装厂商进行工程批封装。工具工程师和测试工程师进行工具和软硬件的开发。待工程批回片后，进行工程批测试，包括研发遍历测试、研发组合测试、可靠性测试等；工程批测试通过后，进行小批量测试；小批量测试通过后，进行试产测试，针对试产测试结果，公司内部进行试产转量产评审，评审通过后，决策管理团队进行可获得性决策评审（ADCP），评审通过后，产品发布。

（4）芯片维护阶段

产品经理召开项目结算会议，IC 设计师进行研发维护，系统和芯片验证工程师进行技术维护，

决策管理团队进行项目绩效考核。

2、销售模式

公司销售分为直销和经销，均为买断式销售。直销的客户群体主要为生产各类终端电子产品的厂商或智能控制器生产商；经销的客户群体主要为方案商和渠道商，方案商具有一定技术开发和外围器件配套能力的企业，其采购的集成电路产品经过二次开发形成整套应用方案，销售给终端客户。

公司与经销商的合作模式为：公司接受经销商订单，将产品销售给经销商，产品交付经销商并由其对质量合格的产品进行验收，除有质量问题外一般情况不予退货，属于买断式销售。产品定价原则为根据产品的类型、价格和数量综合考虑，在市场价格的基础上由买卖双方协商确定。

3、采购模式

在 Fabless 经营模式下，公司专注于芯片的研发、设计及销售，全部的晶圆制造、晶圆测试和主要的芯片封装、芯片测试通过委外的方式完成。因此公司需向晶圆代工厂采购晶圆生产、晶圆测试，向集成电路封装、测试企业采购封装、测试服务。

具体来说，公司研发中心在完成集成电路物理版图的设计后，交由光罩公司根据物理版图制作掩模板，供应链管理依据市场规划向晶圆代工厂下晶圆代工订单，并将掩模板交给工厂进行晶圆生产。

晶圆代工厂完成晶圆生产后，形成集成电路半成品，并根据公司的指令，将其发至特定的集成电路封装、测试企业。

封装、测试企业则依据公司的封装测试订单进行集成电路的封装和测试，完成后形成集成电路成品，经公司质检通过后入库。

公司于 2011 年在四川遂宁建设一条封装测试产线，主要用于新品的快封、快测和特定料号和产品封装、测试。一方面促进了新品的研发，另一方面在封装、测试产能紧张时进行必要的产能调节。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司主营业务为芯片产品的研发、设计与销售，根据所处行业《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”，行业代码“6520”。

集成电路是 20 世纪的一种半导体微型器件，是经过氧化、光刻、扩散、外延、蒸铝等制造工艺，把半导体、电阻、电容等电子元器件及连接导线全部集成在微型硅片上，构成具有一定功能的电路，然后焊接封装成的电子微型器件。集成电路按其功能、结构的不同，可以分为模拟集成电路和数字集成电路两大类。模拟集成电路又称线性电路，用来产生、放大和处理各种模拟信号（指幅度随时间变化的信号，例如温度、压力、浓度等）。而数字集成电路用来产生、放大和处理各种数字信号（指在时间上和幅度上离散取值的信号）。公司具备模拟和数字集成电路设计能力。

(1) 行业发展阶段和基本特点

集成电路是核心技术高度聚集的领域，是国家现代化发展的核心支撑，也是国家竞争力的核心体现。近年来，由于国际形势的变化及竞争加剧，发达国家开始对国内产业的关键芯片实施“卡脖子”政策，因此加大力度发展自主可控的芯片设计技术和芯片产品、发展自主可控的整个产业链技术已成为国家的高科技发展的长期战略。

集成电路产业链主要分为集成电路设计、集成电路制造以及集成电路封装测试三个主要环节。集成电路设计是源头，芯片高度集成了市场应用所需要的功能和性能、集成了高科技核心技术和算法、集成了数模混合设计技术、经验和技巧，处于产业链的上游。在生产制造方面，除了中芯

国际、华虹宏力等大陆晶圆代工厂发展外，也吸引了中国台湾地区和其他国家的芯片制造业厂商投资。在此大背景下，芯片制造业厂商如台积电、格罗方德等纷纷在大陆投资建厂和扩张生产线，晶圆加工工艺持续改进，国内封装测试企业如华天科技、通富微电等技术水平也逐渐达到国际先进水平。我国集成电路产业链逐步成型，持续增加的芯片制造和封测产能极大地降低了 Fabless 集成电路设计企业的成本，同时也增强了芯片产品供货的可靠性，为广大集成电路设计企业的发展提供了良好的产业基础。近几年，我国集成电路产业总体保持着持续快速发展的态势，尤其是中国大陆集成电路产业在资本和政策的支持下，增长显著高于全球平均水平，其中集成电路设计行业与集成电路制造业增速尤为迅猛。

集成电路行业是一个快速发展的高科技行业，各种新技术、新产品层出不穷，一方面带来了巨大的市场机遇，另一方面也导致市场变化较快。根据摩尔定律，当价格不变时，集成电路上可容纳的元器件的数目，约每隔 18-24 个月便会增加一倍，性能也将提升一倍，需要公司不断开发出适销对路的新产品以求跟上市场的需求。集成电路设计行业技术不断革新，持续的研发投入和新产品开发是保持竞争优势的重要手段。

集成电路设计是集成电路产业链的上游环节，属于技术密集型、知识密集型产业，对企业的技术研发实力要求较高，具有技术门槛高、产品附加值高、细分门类多、研发投入大、回报周期长等特点。

（2）行业技术门槛

集成电路设计涉及复杂的电路设计、工艺适配及验证流程，需要掌握 EDA 工具、版图设计及流片经验，其工作内容的专业性、复杂性、系统性、先导性特征，设计企业研发人员需要专业背景和高学历，岗位普遍需要微电子、电子技术等专业本科及以上学历，且需要 3 年以上工作经验，对于高端人才依赖严重，决定了企业进入该行业需突破极高的技术壁垒。同时，集成电路设计产业技术迭代快，企业需要持续投入以保持竞争力。还具有一定的周期性特征，下游需求不断更新，市场热点快速变化。成熟的集成电路设计企业能够基于丰富的技术储备和行业底蕴，进行前瞻性研究、多元化布局，从而维持长期稳定的市场竞争。

近年来，随着国产化浪潮推动，我国集成电路设计行业已成为全球集成电路设计市场增长的主要驱动力。集成电路设计企业数量增长迅速，但大部分盈利能力仍然较低，国产芯片指标差异与系统要求存在差距，高端芯片突破困难，低端芯片一哄而上造成资源分散、低水平重复竞争，集成电路设计行业“内卷”依然存在。

（2）、公司所处的行业地位分析及其变化情况

集成电路是信息技术产业的核心、国民经济的支柱、国家安全的命脉、全球科技竞争的战略制高点，是国家战略性、基础性、先导性产业，新质生产力的关键引擎，科技安全、产业安全和国防安全的核心保障，是数字经济的“心脏”，中国是全球最大集成电路消费国，产业规模庞大，具有超强产业链带动，每 1 元 IC 产值带动约 6.5 倍综合产出，支撑电子信息、装备制造、汽车、通信等数十亿下游市场，属于资金、技术和人才密集行业，具有高壁垒、高投入、高回报的特点，是现代工业的“基石”，所有电子产品的核心，信息技术产业的“粮食”，全产业链的“枢纽”。

集成电路按处理的信号对象不同，通常可分为模拟芯片和数字芯片两大类，前者负责处理连续变化的信号，包括声音、光、温度、电压等现实世界的信号，实现电信号的转换、放大、存储；后者负责处理 0 和 1 的离散信号，进行计算、逻辑、存储，实现大脑的运算和思考。

公司是国内先进的智能控制方案提供商，是以 MCU 为核心的平台型芯片设计企业，同时掌握数字和模拟设计技术，具备 8 位和 32 位 MCU、高精度模拟、功率驱动、功率器件、无线射频和底层核心算法的设计能力，具有技术布局全、产品系列丰富、应用领域广的特点，能为智能控制器提供芯片级一站式整体解决方案。

报告期内，公司在 55 纳米至 180 纳米 CMOS、90 纳米至 350 纳米 BCD、双极、SGTMOS 和 IGBT

等工艺上持续研发投产，并逐步向 40 纳米、22 纳米等更高制程迈进；产品包括 8 位、32 位 MCU、SoC、ASIC 等芯片以及功率器件，产品门类齐全，性价比优势明显，在小家电、消费电子等领域竞争力显著，市场认可度高；在汽车电子领域增长迅猛，车规级 MCU 出货量同比增长超 100%。据弗若斯特沙利文对 MCU 进行详细分析，2014 年公司 MCU 产品以出货量计在国内厂商排名第一，以收入计在国内厂商排名第三。报告期内，各类产品出货量持续增加，全年 MCU 出货量超 36 亿颗，同比增长超过 50%，其中 8 位机出货量超过 33 亿颗，市场份额稳居国内厂商龙头；32 位机出货量约 3.0 亿颗，市场份额持续扩大。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

集成电路设计出现技术和产品融合的趋势。传统数字芯片（逻辑、计算、存储）与模拟芯片（信号采集、电源、射频、驱动）长期分立设计、独立制造、板级互联，随着各设计公司技术提升与突破，无论是通过内生式发展突破，还是通过外延式吸收兼并，各设计公司的技术和产品界线在逐渐打破，传统的数字芯片设计企业走向模拟芯片的设计，传统的模拟芯片设计企业走向数字芯片的设计，并不断向数模电路在芯片、封装、系统三层深度协同，实现“感知-处理-控制-驱动”一体化。

不同应用场景对 MCU 性能、功耗、运行温度、可靠性具有不同要求，客制化的设计提高了设计者对下游产业需求的认知壁垒，同时也加速产品更新迭代。

智能电动化推动车规级 MCU 需求全面爆发，特别是新能源车单车 MCU 需求远超传统燃油车数量，而域控制、智能驾驶、座舱等拉动高算力、高安全车规 MCU 需求。2025 年全球车规 MCU 市场规模超过 300 亿美元；车规 MCU 国产替代加速，国内各大设计公司纷纷将研发重心向车规级芯片转移。

端侧 AI、机器人、低空经济等新兴领域催生 MCU 需求，未来 MCU 设计将向更高算力、高性能、高智能，以及更低功耗、更安全、更小尺寸和集成无线通信、语音识别等功能方面发展。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年 增减(%)	2023年
总资产	3,679,356,651.96	3,309,304,222.53	11.18	3,151,080,027.72
归属于上市公司股东的净资产	3,177,389,907.69	2,993,369,852.65	6.15	2,971,638,437.37
营业收入	1,122,150,053.86	911,654,675.00	23.09	713,569,748.57
利润总额	305,029,744.50	137,632,289.67	121.63	-33,537,870.89
归属于上市公司股东的净利润	284,181,478.86	136,833,872.76	107.68	-21,948,515.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	169,067,263.28	91,174,716.23	85.43	-71,352,340.06
经营活动产生的现金流量净额	260,477,632.74	312,850,036.90	-16.74	20,713,377.38

额				
加权平均净资产收益率 (%)	9.24	4.59	增加4.65个百分点	-0.71
基本每股收益 (元/股)	0.71	0.34	108.82	-0.05
稀释每股收益 (元/股)	0.71	0.34	108.82	-0.05
研发投入占营业收入的比例 (%)	11.07	13.99	减少2.92个百分点	16.88

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	206,498,167.84	297,462,701.18	269,052,171.54	349,137,013.30
归属于上市公司股东的净利润	34,420,237.01	52,049,327.20	65,818,511.01	131,893,403.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	32,580,109.54	43,180,806.77	29,943,916.49	63,362,430.48
经营活动产生的现金流量净额	56,154,574.22	94,960,081.53	73,360,409.05	36,002,567.94

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4、 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	24,140
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	34,545
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	/
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	/

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
杨勇	0	126,000,000	31.47	126,000,000	无	0	境内 自然人
周彦	0	91,800,000	22.93	91,800,000	无	0	境内 自然人
蒋智勇	-500,000	15,700,000	3.92	0	无	0	境内 自然人
罗勇	-131,636	15,402,403	3.85	0	无	0	境内 自然人
周飞	0	13,500,000	3.37	13,500,000	无	0	境内 自然人
顺为芯华（深圳） 投资有限合伙企业（有限合伙）	-3,428,095	11,556,905	2.89	0	无	0	境内 非法人 国法人
宁波顺为至远创 业投资合伙企业（有限合伙）	-1,018,837	5,107,078	1.28	0	无	0	境内 非法人 国法人
吉娜娜	0	3,214,305	0.80	0	无	0	境内 自然人
香港中央结算有 限公司	20,328	1,792,710	0.45	0	无	0	其他
深圳市达晨财智 创业投资管理有 限公司—深圳市 达晨创鸿私募股 权投资企业（有 限合伙）	-1,533,966	1,616,034	0.40	0	无	0	境内 非法人 国法人
上述股东关联关系或一致行动的说明				股东杨勇、周彦、周飞为一致行动人及公司共同			

	实际控制人：杨勇控制的企业丰泽一芯（深圳）贸易有限公司为顺为芯华（深圳）投资有限合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人并持有42.03%出资份额。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

存托凭证持有人情况

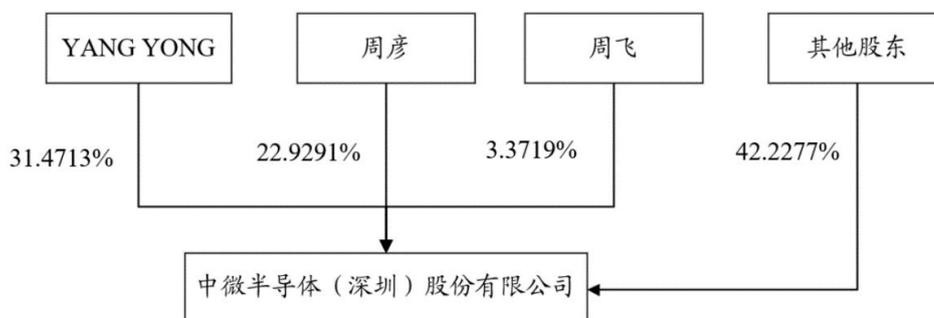
适用 不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

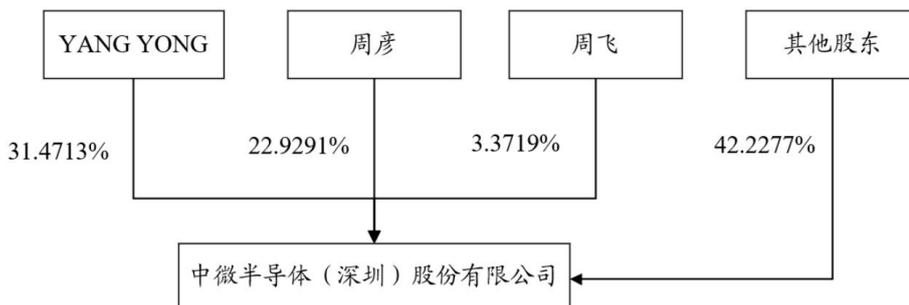
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

适用 不适用

5、公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内的公司主要经营情况详见本报告“第三节 二、经营情况讨论与分析”的相关内容。

2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用